

6-102617-3 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

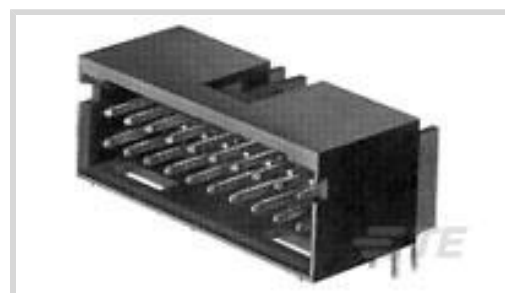
TE 内部编号 6-102617-3

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 30 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 30

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|---------------------|----|
| 行数 | 2 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向 | 直角 |
| Number of Positions | 30 |

电气特征

| | |
|------------|----------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 介质耐压 (最大值) | 750 Vrms |

主体特性

| | |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|

接触件特性

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 接合方柱尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin] |
| 端子形状和构造 | 正方形 |



| | |
|----------------|-----------------|
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .381 μm[15 μin] |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A |

端接特性

| | |
|-------------|------------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.43 mm[.135 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|----------|--------|
| 接合固定 | 带有 |
| 接合固定类型 | 制动器窗口 |
| 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

| | |
|----------|----------------|
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | 热塑性 |

尺寸

| | |
|--------------------|-----------------|
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in] |
| PCB 厚度 (建议) | 1.4 mm[.055 in] |

使用环境

| | |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 标准 |
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

操作/应用

| | |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座 |
| 电路应用 | Signal |



行业标准

| | |
|----------|-----------------------|
| 已批准的标准 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| 机构/标准 | CSA |

包装特性

| | |
|------|---------|
| 封装数量 | 112 |
| 封装方法 | Package |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 240°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



客户还购买了





文档

产品图纸

[30 MODII HDR DRRA SHRD LF](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_6-102617-3_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_6-102617-3_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_6-102617-3_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本